

半導体・製品開発プロセスの

全工程をフルサポート



お客様のモノづくりの課題をスピーディに解決

試作ワンストップサービス

試作サービスをワンストップでサポート。資材調達や納期調整などのわずらわしさを解消し、開発業務に集中できる体制づくりができます。



同サービスの主な特長

- 設計・調達から量産化支援までワンストップで対応可能
- 東芝グループとして蓄積したノウハウと充実の設備
- 「世の中にまだないもの」を企画の段階からサポート

「世の中にまだないもの」を



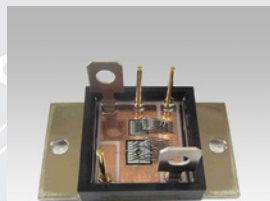
ゼロから創り出す

東芝生産技術センターのノウハウを活かす

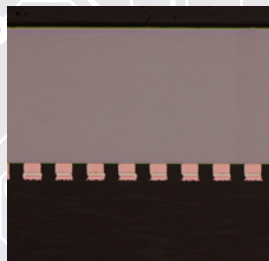
最先端生産技術をカバー

1. 半導体ソリューション

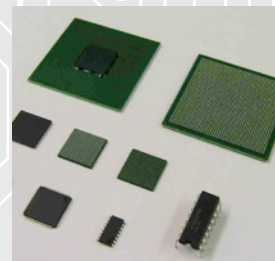
- 超小型モジュールやパワーモジュールの実装構造設計から部材評価、プロセス評価、モジュール試作、量産化支援までサポート
- 実装評価用ダミーパッケージから実ICチップによる動作パッケージまで、各種半導体パッケージングプロセス開発・試作をフルサポート
- ワイヤボンディングプロセスやフリップチッププロセスが可能な設備とノウハウを保有



パワーモジュール試作例



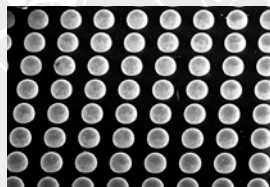
大型チップ(30mm 口)実装例



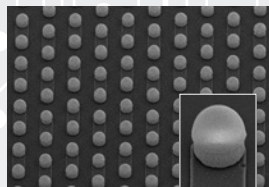
半導体パッケージ試作例

2. TEG ウェハ(チップ)ソリューション

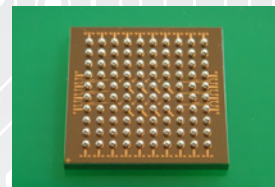
- カスタム対応
- 「PKG 開発」「実装プロセス開発」「装置開発」「特性評価」「機能評価」「材料評価」等に適したツールをご提供



はんだパンプ加工例



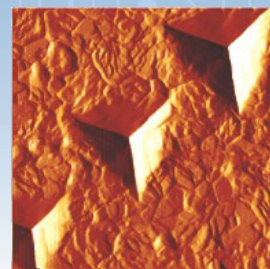
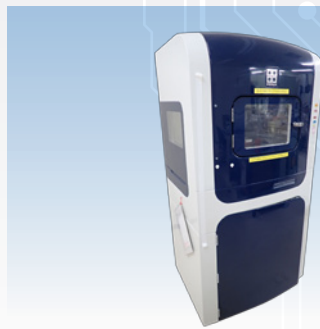
Cuピラー加工例



再配線 (RDL) 加工例

3. 評価・解析ソリューション

- 様々な半導体製品の各種材料分析と評価、製品解析、信頼性評価を実施
- ナノインデントによる「微小領域の硬さ」を測定でき、クオリティの高い硬度測定が可能



Al-Si-Cu

ナノインデントによる測定例

4. 3D-AMソリューション

- 意匠 (設計・デザイン / 勘合) 確認等に活用
- 実物があれば図面化・製作も可能 (デザイン変更にも対応)
- 開発期間の大幅な短縮



□ お問い合わせ先

東芝ビジネスエキスパート株式会社 生産技術ソリューション事業部

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町 33 番 TEL 045-759-1550 FAX 045-759-1552 URL www.toshiba-bexpert.co.jp